三集瑞科技 國際集團股份有限公司
TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

2026年第一季營運報告

報告人：林伙利董事長

股票代號：6862

經營實績


Customization & Innovation
Cost efficient v.s. high quality products

貳:經營實績

➢ 簡明損益表

會計科目	2023年度	2024年度	2025年度	2026年第一季
營業收入	1,594,621	2,200,240	2,265,718	471,241
營業成本	857,300	1,285,173	1,354,351	317,837
營業毛利	737,321	915,067	911,367	153,404
營業費用	251,213	370,870	353,493	92,656
營業利益	486,108	544,197	557,874	60,748
營業外收入及支出	5,755	129,607	-45,230	9,819
稅前淨利	491,863	673,804	512,644	70,567
所得稅費用	99,527	158,181	98,133	20,430
稅後淨利	392,336	515,623	414,511	50,137
每股盈餘	9.02	11.41	8.29	1.00

單位：新台幣仟元

貳:經營實績(續)

NT$仟元	2024年合計	2025年Q1	2025年Q2	2025年Q3	2025年Q4	2025年合計	2026年Q1
營業收入	2,200,240	610,380	649,029	503,013	503,296	2,265,718	471,241
營業成本	1,285,173	362,834	367,553	311,865	312,099	1,354,351	317,837
營業毛利	915,067	247,546	281,476	191,148	191,197	911,367	153,404
營業費用	370,870	93,079	81,902	80,561	97,951	353,493	92,656
營業利益	544,197	154,467	199,574	110,587	93,246	557,874	60,748
營業外收入及支出	129,607	40,891	-188,375	55,409	46,845	-45,230	9,819
稅前淨利	673,804	195,358	11,199	165,996	140,091	512,644	70,567
所得稅費用	158,181	35,623	11,182	24,931	26,397	98,133	20,430
淨利歸屬於母公司業主	515,623	159,735	17	141,065	113,694	414,511	50,137
EPS	11.41	3.19	0.00	2.82	2.27	8.29	1.00

重要財務比率（%）							
毛利率	41.59%	40.56%	43.37%	38.00%	37.99%	40.22%	32.55%
營業費用率	16.86%	15.25%	12.62%	16.02%	19.46%	15.60%	19.66%
營業利益率	24.73%	25.31%	30.75%	21.98%	18.53%	24.62%	12.89%
稅率	23.48%	18.23%	99.85%	15.02%	18.84%	19.14%	28.95%
淨利率	23.43%	26.17%	0.00%	28.04%	22.59%	18.29%	10.64%

單位：新台幣仟元

貳:經營實績(續)

2026年Q1度營運成果

- ✓ 本公司2026年第一季度營業收入為新台幣4.71億元，較去年同期新台幣6.1億元，減幅為22.80%。
- ✓ 本期淨利為新台幣50,137仟元，較去年同期新台幣159,735仟元減少109,598仟元，減少68.61%。
- ✓ 每股盈餘為1.00元。

主要因素

- ✓ 受到全球記憶體供需吃緊影響，部分供應鏈拉貨動能放緩，在整體產能利用率未達經濟規模下，使獲利表現略低於預期。

貳:經營實績(續)

➢ 簡明資產負債表

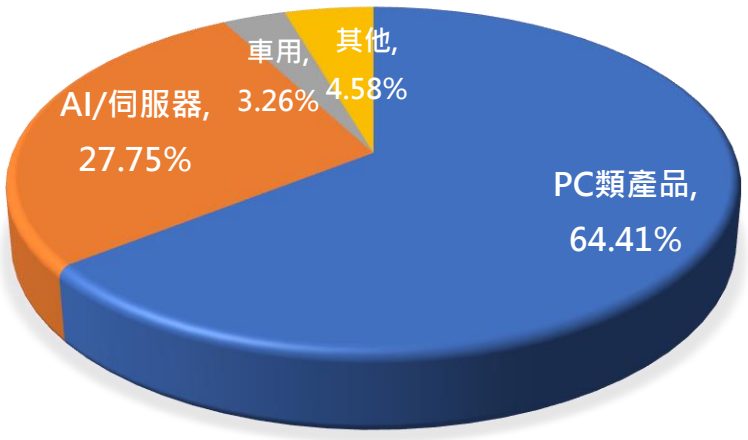
NT$仟元	2022/12/31	2023/12/31	2024/12/31	2025/12/31	2026/3/31
資產總額	1,873,339	2,783,725	3,971,774	4,450,719	5,565,992
現金及約當現金	407,020	634,049	1,033,514	717,589	1,689,547
應收帳款及票據	438,296	676,252	904,614	830,491	818,191
存貨	189,517	253,181	381,794	334,204	418,377
不動產廠房及設備	584,417	659,540	999,472	1,883,384	1,896,050
負債總額	737,931	1,313,777	1,085,105	1,466,240	2,438,059
應付帳款及票據	124,173	218,567	387,349	273,865	345,576
權益總計	1,135,408	1,469,948	2,886,669	2,984,479	3,127,933
股本	420,000	440,000	500,000	500,000	500,000
重要財務比率（%）					
應收帳款天數	125.89	127.56	131.13	139.76	159.62
存貨週轉天數	118.78	103.16	90.17	96.48	108.03
應付帳款週轉天數	72.11	71.97	86.04	89.10	88.92
現金循環週期	165.15	158.75	135.25	147.14	178.74
ROE(%)	35.11%	30.12%	23.67%	14.12%	1.64%
ROA(%)	19.87%	17.18%	15.71%	10.05%	1.10%

單位：新台幣仟元

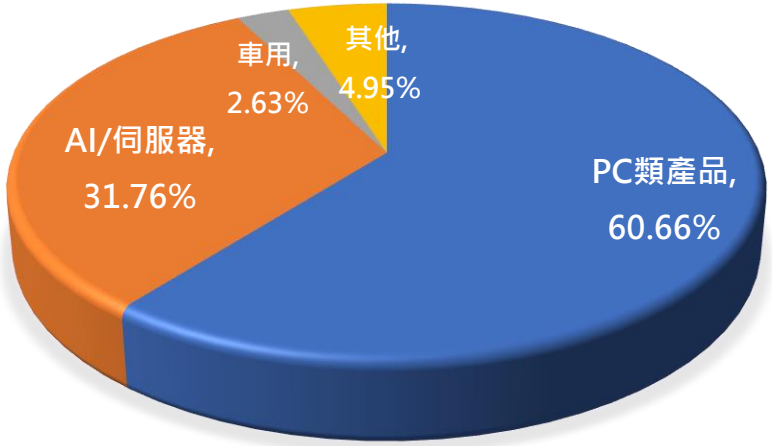
貳:經營實績-應用市場(續)

應用領域	2023年度	2024年度	2025年度	2026年截至4月
PC類產品	78.52%	64.41%	60.66%	47.29%
AI/伺服器	13.03%	27.75%	31.76%	35.56%
BBU	0%	0%	0%	6.42%
車用	1.17%	3.26%	2.63%	3.76%
其他	7.28%	4.58%	4.95%	6.97%
合計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

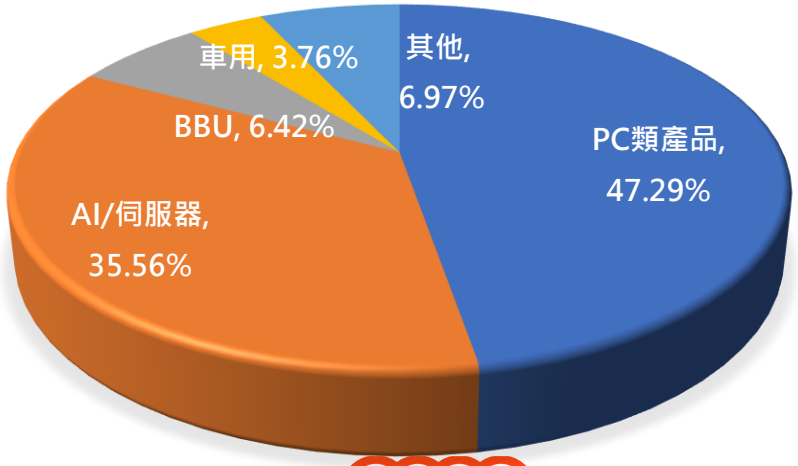
2024年度



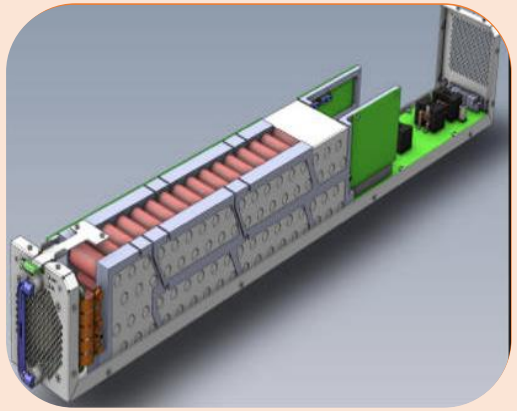
2025年度



截至2026年4月

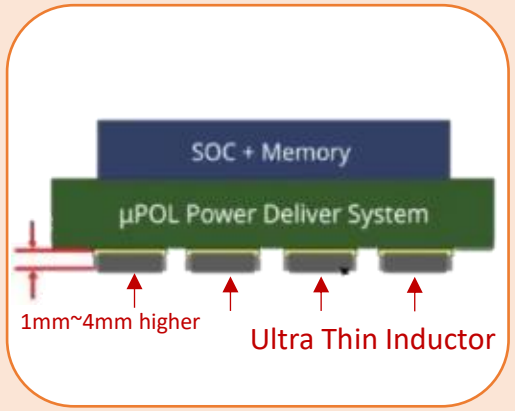


參:未來發展策略_產品方向



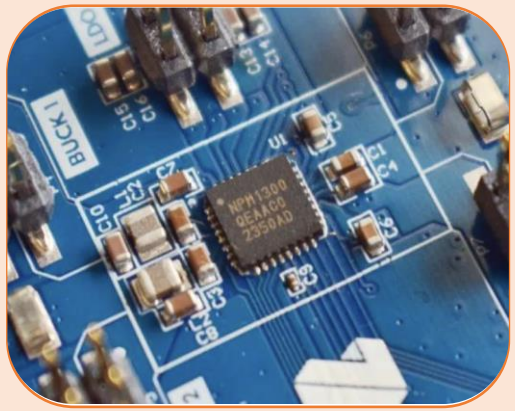
大功率電源供應器 (大電流磁性元件)

- 因應AI伺服器機櫃機構設計，設計高功率密度磁性元件。
- 使用高性能磁性材料，配合新式線路架構，高度客製化功率磁件。
- For SST/HVDC應用高絕緣設計。



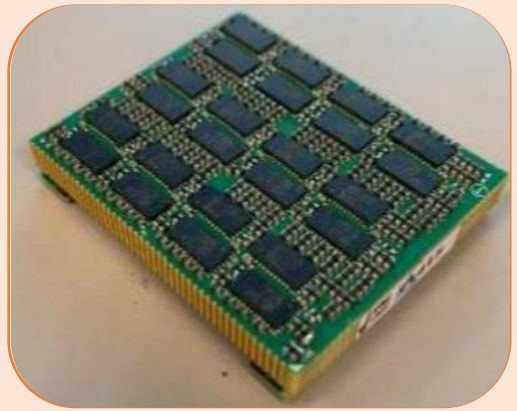
垂直供電應用 (VPD) (低高度電感)

- 電路板上的設計空間有限，將功率電感器放置在電路板下方，有效利用底部金屬機構設計散熱。
- 特低高度電感器設計。
- 最短的電源路徑可提高效率。



PMIC (微型化電感)

- NPU/CPU 低功耗多線式供電需求，PMIC方案提供完善DC/DC供電。
- 成熟且完整的高密度電感製程完成微型電感mini molding開發。



電源模塊 (集成式電感)

- 與IC/ASIC方案商合作開發電源模塊電感，DC/DC整合式電源解決方案可提高功率密度。
- 第一級(48~52V/12V)與第二級(12/1V)完整方案。
- 最小體積&最大功率密度。

參:未來發展策略_AC/DC電源轉換磁件

- BBU(Battery Backup Unit)：
  - AI伺服器電源架構中的備援電池系統，目前已導入多間電源大廠，終端客戶為Nvidia與CSP廠。
  - 目前開發方向以縮小磁件體積，並提升產品效能與功率密度為目標。
- 800V HVDC AC/DC PSU：
  - 因應高壓800VDC絕緣系統需求，給國內多家電源大廠進行高功率磁性元件進行客製化開發，功率3.3kW~12kW，客戶含概國外CSP與AI廠。
- SST固態變壓器：
  - 試樣品已完成35kV絕緣測試，且已在國內電機大廠送樣導入階段。



Nvidia ORV3 MGX

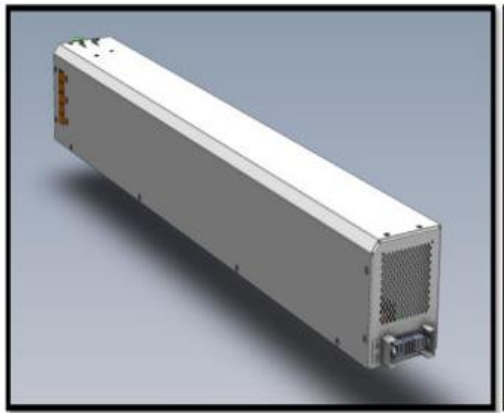


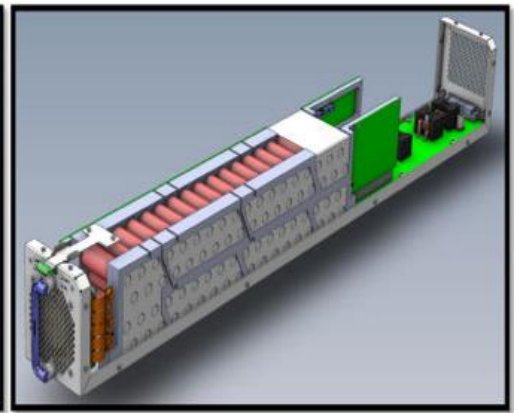
Nvidia GB300 NVL72



Nvidia RUBIN 800HVDC







參:未來發展策略_垂直供電, 電感模塊

- 垂直供電 (Vertical Power Delivery, VPD)：
  - 運用高密度電感製程開發系列低高度電感產品，目前高度以1.2mm/1.5mm/1.8mm等為主要目標，已陸續開發並試樣。
  - 筆記型電腦INTEL新的Penther Lake平台產品開發。

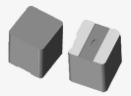
Product	Inductance (uH)	Size (mm) Max.	DCR (mΩ)	Irms (A)	Isat (A)
HM-15BM25VC2	0.15	5.5 x 5.3 x 3.0	0.74	38	45
EM-22AM84V02	2.2	8.5 x 8.9 x 4.0	9.41	12	20
HM-15AM25VC2	1.5	5.5 x 5.3 x 3.0	7.2	14	15
EM-10AM05V32	1	6.9 x 7.5 x 3.0	10.0	12	22
EM-12BM1NVC8	0.12	5.9 x 10.5 x 4.0	0.65	45	120
EM-15BM1NVG9	0.15	5.9 x 10.5 x 4	0.63	45	100

Product	Inductance (uH)	Size (mm) Max.	DCR (mΩ)	Irms (A)	Isat (A)
EM-10AM05V36	1.0	7.3 x 6.8 x 3.0	6.4	12	15
EM-22AM05VG6	2.2	7.3 x 6.8 x 3.0	11	12	15
EM-15AM05V29	1.5	7.3 x 6.8 x 3.0	7.2	14	15
HM-15BM05VC3	0.15	6.8 x 6.6 x 3.0	0.6	44	69

- 電源模塊電感 (Power Module Inductor)：
  - 與IC與ASIC廠商合作開發多個電源模塊電感專案，目前已開發有14款電感，已陸續進行試產，預計下半年進入量產。
  - Nvidia 新世代AI平台 Feynman對應產品已完成開發送樣。

高功率電感(低高度)
- 高功率密度
- 大電流設計
- 耦合電感設計
- 雙繞組/多繞組電感設計

Single Inductor MP
HM/FM Series
A23_85nH



Flat Inductor Sample
HM Series
For VGA, AI application



Dual Inductor MP
HM/FM Series
A24_Dual 85nH

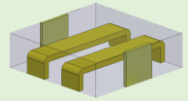


TLVR Inductor Sample
HM Series
A51_100nH



電源模塊電感
- 高度整合設計
- 完全客製化開發
- 多相式TLVR設計

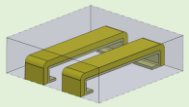
Dual phase module Inductor MP
HM Series
Dual_60nH
9.0*2.4*7.2

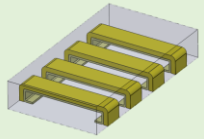


Multi phase TLVR module Inductor
HM Series

MP

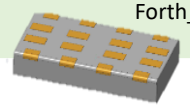
Sample





Dual_65nH

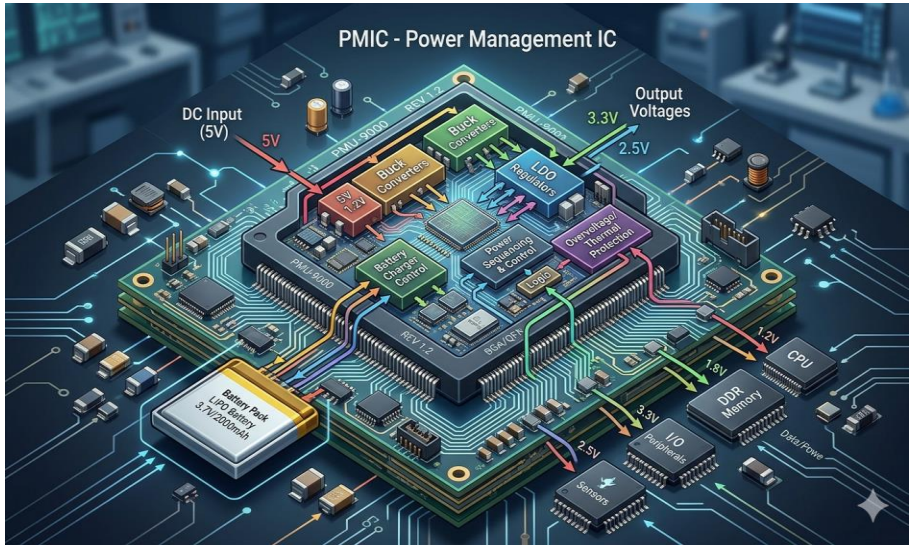
Forth_45nH

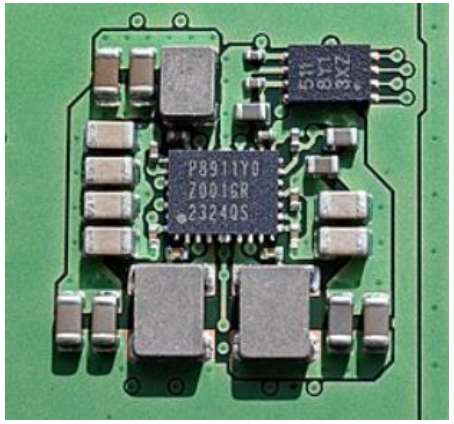


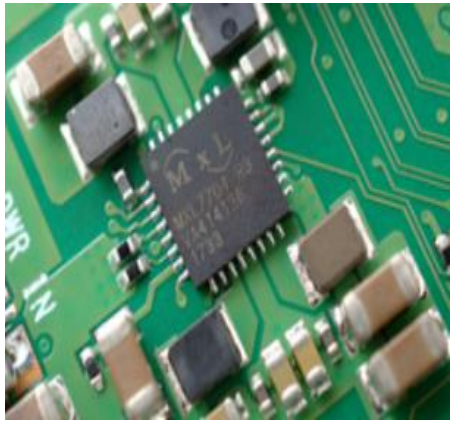
參:未來發展策略_PMIC

- PMIC (Vertical Power Delivery, VPD)：
  - 對應高通(Qualcomm)或英特爾(INTEL) CPU/NPU平台，搭配PMIC供電，開發Mini Molding產品，已完成全系列從3225~1412全尺寸產品開發。
  - 現階段正在進行更小尺寸1005的產品開發，預計Q3可送樣。

Series	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Inductance (μH)	DCR Range (mΩ)	Irms (A)	Isat (A)
HP-13E	1.4	1.2	0.8	0.24 ~ 1	22 ~ 65	4.1 ~ 3	6 ~ 3
HP-02E	1.6	0.8	0.8	0.22 ~ 10	33 ~ 1450	3.4 ~ 0.5	5.5 ~ 0.8
HP-03E	2.0	1.2	0.8	0.11 ~ 4.7	10 ~ 285	7 ~ 1.7	9.5 ~ 1.6
HP-03T	2.0	1.2	1.0	0.1 ~ 10	8 ~ 600	7.5 ~ 1.5	8.5 ~ 1.2
HP-04E	2.0	1.6	0.8	0.22 ~ 10	14 ~ 690	6.6 ~ 1	6.1 ~ 1
HP-04T	2.0	1.6	1.0	0.1 ~ 10	7 ~ 485	8.5 ~ 1	9 ~ 1.4
HP-04B	2.0	1.6	1.2	0.1 ~ 4.7	4 ~ 165	12 ~ 2.4	13 ~ 2.7
HP-05T	2.5	2.0	1.0	0.1 ~ 22	6.8 ~ 1100	9 ~ 0.85	9.2 ~ 1.1
HP-05B	2.5	2.0	1.2	0.1 ~ 10	10 ~ 330	9.5 ~ 1.2	13.5 ~ 1.6
HP-07B	3.2	2.5	1.2	0.1 ~ 10	5.2 ~ 210	12 ~ 2.2	18 ~ 2.3







參:未來發展策略_TLVR

- TLVR 產品開發與推廣：
  - Nvidia Rubin Ultra與Feynman平台的低高度TLVR完成開發，目前送測階段。
  - INTEL和AMD伺服器CPU平台已完成TLVR產品系列開發，並完成量產與導入國內外伺服器大廠。
  - Molding TLVR產品已導入品牌大廠，首批完成交付，預計下半年進入量產。

intel XEON

Eagle Stream
Emerald Rapids
10nm++
DDR5
350-400W

Birch Stream
Granite Rapids
3nm
DDR5
400W+

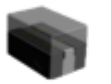
AMD EPYC

AMD Zen4
Genoa
5nm
DDR5
320-400W

AMD Zen5
Turin
3nm/4nm
DDR5
380-600W


MP

Assembly Type (VR/LC)
EB-5LP Series
(10mm*6mm*12mm)
EB-4LP Series
(10mm*5mm*12mm)


MP

Assembly Type (LC)
EB-4YP Series
(9.6mm*6.4mm*8.0mm)
EB-5RP Series
(6.5mm*6.5mm*10mm)


MP

Assembly Type VR (VR/LC)
EB-5LP Series
(10mm*6mm*12mm)
EB-4LP Series
(10mm*5mm*12mm)


MP

Assembly Type (LC)
EB-4YP Series
(9.6mm*6.4mm*8.0mm)
EB-5RP Series
(6.5mm*6.5mm*10mm)


MP

Molded Type (High Density)
HM-A19VT Series (6060)
HM-A20VT Series (1060)
HM-A21VT Series (1010)
HM-A28VT Series (8080)
HM-A29VT Series (1510)


MP

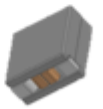
Assembly Type TLVR
EB-7LS Series
(12mm*6mm*11mm)
EB-5LS Series
(10mm*6mm*12mm)
EB-4LS Series
(10mm*5mm*12mm)


MP

Assembly Type TLVR
EB-7NS Series
(12mm*6mm*8mm)


MP

Assembly Type TLVR
EB-5QS Series
(11mm*7.5mm*12mm)
EB-5GS Series
(12mm*6mm*12mm)


MP

Assembly Type TLVR
EB-5MS Series
(9mm*5mm*12mm)



MP

Molded Type TLVR
HM series
11mm*6mm*7.5mm
10mm*5mm*10mm



Sample

Molded Type TLVR
HM series
7.5mm*7.5mm*13mm

Thank You

三集瑞科技 國際集團股份有限公司

TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.